

TECHNICAL DATA SHEET

Version 3.0

中文版 Revision Date 2016/09

TECORE® “超效清模” 橡胶 C60-H

TECORE® 清模橡胶C60系列应用于半导体集成电路、半导体分立器件、半导体光电器件的环氧树脂转移成型(Transfer Molding)的塑封工艺，专门清除环氧树脂连续封装在模腔、模面等处产生的影响封装质量的树脂残胶、有机氧化物等污染物。

C60系列是片状材料，无需金属引线框架，通过模具直接压合以及加热固化一定的时间，即可达到良好的清洁效果。

“高效清模” C60-H是C60产品家族中最新开发的型号，它显著提高了清模的效率和效果以应对如下应用对清模材料的挑战：

- 小而且深的模具型腔
- 镜面镀铬的型腔表面
- 极易粘模的环保塑封料(green compound)

C60-H也广泛的适用于大多数的模腔设计，其优秀的清模能力有效的提高半导体封装的生产效率。

主要性能

- 高超的清洁效果
- 使用100%圆滑形状填料，以最大程度地减少对于模具表面的机械磨损
- 环保配方，水溶成份，气味轻微（另附德高化成EHS提供的挥发气体检测报告）
- 对于绿色封装树脂的超强清洁能力

TECHNICAL DATA SHEET

Version 3.0

中文版 Revision Date 2016/09

1. 物理特性

性能	数据
外观	白色或淡黄色
比重	1.02~1.20 g/cm ³
最低扭矩	0.15~0.85 N•m
最大扭矩	1.50~4.00 N•m

2. 使用方法

常规固化条件

模具表面温度	固化时间	重复清模次数
161~175℃	7~10 min	4-8 模
176~190℃	5~8 min	4-8 模

***注意：**最佳固化时间可能根据应用产品封装形式 (package type) 、 模具结构 (molding die) 的不同而有差异。

****注意：**请向当地的销售或者代理机构索取德高化成塑封模具保养用品的用户手册，按照手册的指示使用本产品。

3. 尺寸

可以提供的尺寸

- 产品为片状，10~25 条半切条拼成一片
- 尺寸代码：德高化成清模片产品的尺寸使用如下尺寸代码表示：

230 * 10 * 7 / W250mm
条长*条宽*厚度/W 整片宽度

标准尺寸	其他可以提供的尺寸		
	半切条长度	半切条宽度	厚度
250*10*8/W250mm 210*7*5/W250mm 230*15*5/W250mm	<=300mm	7mm,10mm,15mm	3mm~8mm

TECHNICAL DATA SHEET

Version 3.0

中文版 Revision Date 2016/09

4. 包装

清模片4-8片由隔离膜隔开装入塑料袋中，塑料袋设有自封口。根据产品特性，我们会选用普通PE塑料袋或镀铝膜塑料袋包装产品。塑料袋外面喷码标记产品名称、规格、批号。

5. 存储条件

本公司建议用户按以下条件管理清模片的存储和使用：

5.1 请将清模片保存在5°C 或以下的环境。使用前需解冻18-24小时（整箱）或者2~4小时（小包装）直至产品本体的温度与室温平衡。产品尚未与室温平衡时打开包装会造成清模片表面吸附空气中的潮气，对使用效果有一定不良影响。

5.2 避免将清模片放置在接近热源的地方，如塑封模具、金属支架预热板等。不可控的热量吸收会导致产品性能的改变

5.3 储存期限：储存条件合乎标准的情况下，产品的性能在制造日期后的12个月能够保持不变。

5.4 使用期限：在不打开包装且置于室温条件下，本产品可以存放30天。

5.5 需要二次入库的材料，请返回装入产品的塑料袋包装中，并封紧自封口。

5.6 最佳的运输温度低于 5°C。然而，在国内运输的情况下，如果运输时间不超过15天，可以采用普通货柜卡车（即非冷藏车）运输，储存期限以及使用期限也不会受到影响。

对工作环境影响的说明

清模胶的主要成分是合成橡胶，在塑封温度下与固化剂发生硫化交联反应，形成有一定机械强度的空间网状高分子固化物。硫化交联反应进行时会伴有固化剂的分解。许多用于交联合成橡胶的固化剂分解产生的小分子气体，由于分子结构上含有“枯基”，因此具有刺激性气味，会使塑封车间的操作员感到不适。

本产品硫化交联反应时，分解产物是仅包含正丁醇、异丙醇、丙酮等无刺激性气味小分子气体，确保了绿色的工作环境。

尽管本产品硫化时无刺激性气味，但释放出的有机小分子气体仍需采用强制排风排出生产车间。一般塑封机都配有排风装置（建议风量不小于12m³/min，风速不小于0.5m/s），要正常开启排风即可。

注意：以上所列代表性技术信息和数据仅供参考，不可作为技术规格